

ECOFREC™ TF48



无卤粘性助焊剂

卓越的印刷和点涂性能

产品优势 | BENEFITS

ECOFREC™ TF 48是一款无卤、免清洗粘性助焊剂，专为无铅和含铅应用而设计。回流焊后，残留物无腐蚀性。

推荐用于：

- 锡球焊接
- 元件返工 (BGA、SMT元件)
- 倒装芯片工艺
- 焊片及芯片的固定

一流的点涂、蘸涂和印刷应用

规格参数

助焊剂外观	琥珀色
密度20°C (g/cm ³)	1
水中溶解度	不溶
在酒精中溶解度	易溶
卤素含量	无卤
粘度 (20°C时Pa.s) (Brookfield RVT TF, 转速为 5 RPM)	350 - 550

性质

ECOFREC™ TF 48 是一种高粘度粘性助焊剂。

- 不含卤化物（氟化物、氯化物、溴化物）和胺
- 无腐蚀性残留物
- 松香、活化剂和溶剂的复杂混合。

标准测试	结果	程序
助焊剂分级	ROLO	ANSI/J-STD-004
SIR/电迁移 (IPC)	通过	ANSI/J-STD-004
BONO腐蚀测试 85°C/85%RH - 15天	通过: Fc < 1%	Inventec MO.SB.10029
铬酸盐纸	通过	ANSI/J-STD-004
铜镜测试	通过	ANSI/J-STD-004

工艺参数

ECOFREC™ TF 48 可通过点涂、浸渍、刷涂或钢网印刷等方式使用。

ECOFREC™ TF 48的粘性特性可确保部件在合金回流之前保持在原位。ECOFREC™ TF 48可采用多种回流方法来产生焊点；这些包括烙铁、热气和热棒设备、红外线或对流烤箱或气相。

清洗

焊接后，ECOFREC™ TF 48上残留的助焊剂残留物无需用清洗操作去除，因为它具有化学惰性。然而，如果需要清洗，回流焊后留下的残留物可以根据需要使用多种清洗剂轻松去除，例如清洗剂、碳酸氢溶剂或卤化溶剂，所有这些都包含在清洁系Inventec 系列中。

工艺类型	INVENTEC去助焊剂解决方案
手工	Topklean™ EL10F/ Topklean™ EL60/ Quicksolv™ DEF90 EL
水基系统 (浸没或喷淋)	Promoclean™ DISPER 707 和 DISPER 800
双溶剂	Topklean™ EL 20 系列
真空系统下	Topklean™ EL 20D
单溶剂 (共沸)	Promosolv™ 70ES

包装、储存和保质期 | PACKAGING, STORAGE & SHELF LIFE

为确保产品最佳性能，建议储存温度范围为室温。

为了获得最佳保存效果，请将卡桶和针筒包装垂直存放，尖端朝下。

针筒	10g或30g	18个月
塑料罐	100g或500g	18个月

环保 | HSE

在通风良好的地方使用。处理助焊剂时应始终佩戴安全眼镜和手套。

按照建议使用时没有问题。使用前请参阅材料安全数据表。

INVENTEC材料安全数据表可在 www.quickfds.com 上找到。

根据指令2011/65/UE(RoHS)附件I 及其修正案，我们证明本产品的Hg、Pb、Cr VI、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP含量不超过0.1%、DIBP及Cd 0.01%以上。INVENTEC高性能化学品还履行REACH 和冲突矿物法规规定的直接义务。

该数据基于制造商认为可靠且善意提供的信息。在任何情况下，INVENTEC均不对特殊、偶然和后果性损害负责。用户对其安装的符合性向行政当局（环境保护法规）负责。

BRY-FP-274-v3-GB-1/10/2020

Inventec Performance Chemicals - 26 rue de Coulons, 94360 Bry-sur-Mame, France
Limited company with capital of 600 000€ - 964 500 706 RCS Créteil